

investor

newsletter

IM FOKUS

- 2-3 ■ Die Revolution beim Stromsparen

TRENDS & THEMEN

- 4 ■ Titan Infineon im neuen Dow Jones Blue Chip Index
- Infineon auf der CeBIT
- Prognosen signalisieren Markterholung
- Patentstreit: Rambus unterliegt Infineon

ENTWICKLUNG & PRODUKTE

- 5 ■ Portemonnaie bald ohne Kartenchaos
- Chip-Stärken unter der Kühlerhaube
- Erste 1- und 2-Gigabyte-Speicher ausgeliefert
- Elektronischer Fahrschein: einer für alle

ZAHLEN & FAKTEN

- 6-7 ■ Höhere Durchschnittspreise für Speicherchips

AUSBLICK

- 8 ■ Ausblick: Positive Signale
- Neues Joint Venture in Taiwan

SPECIAL 50 JAHRE HALBLEITER

- Mit dem Notebook zum Mond – 50 Jahre Halbleiterindustrie in Deutschland



Infineon mit Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft 2001 ausgezeichnet – Leistungshalbleiter senken Stromverbrauch deutlich

DIE REVOLUTION BEIM STROMSPAREN

Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft für Halbleiter-Familie von Infineon

Damit Technologieunternehmen wachsen und gedeihen, bedürfen sie eines besonderen Lebenselixiers – der Innovation. Und gerade der dynamische Halbleitermarkt verlangt in kurzen Zeitabständen nach immer neuen Lösungen. Nicht selten übernimmt Infineon dabei die Rolle des Pioniers. Eine Rolle, die jetzt sozusagen mit einem Oscar geadelt wurde: dem Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft 2001. Geehrt werden damit herausragend innovative Produkte oder Verfahren, die „Deutschlands Ansehen als Technologie-Nation in der Welt“ festigen können. Infineon erhielt die Auszeichnung, die seit 1980 jährlich vom Wirtschaftsclub Rhein-Main und der Wirtschaftswoche ausgelobt wird, in der Kategorie Großunternehmen.

CoolMOS und IGBT heißen die Erfindungen, die Infineon diese hohe Ehrung eingetragen haben. Hinter den Abkürzungen verbergen sich Transistoren, die hohe Ströme punktgenau steuern können. Die beiden Leistungshalbleiter-Familien haben eine beispiellose Karriere vor sich: Sie werden in Zukunft milliardenfach zur Grundausstattung von Autos und Haushaltsgeräten, Industriemotoren und Personalcomputern gehören – die dann bis zu 30 Prozent weniger Energie verbrauchen.

Mit CoolMOS Kraftstoff reduzieren

Bei Autos können die MOS-Elektronikbausteine den Benzinverbrauch zukünftig um bis zu 1,5 Liter je 100 Kilometer sen-

alles im Griff haben. Kühlschränke, die mit der neuen Technik ausgestattet sind, werden weniger Energie verbrauchen. Hi-Fi-Geräte oder Computer benötigen im Stand-by-Betrieb so gut wie keine Energie mehr – und die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen.

Industrieanlagen auf halber Ration

Zum Beispiel mit Elektromotoren, die rund die Hälfte des deutschen Energieverbrauchs ausmachen. Nach einer Beispielrechnung ließe sich mit den sinnvoll eingesetzten Halbleiterelementen allein in den USA Energie im Wert von jährlich 80 bis 100 Milliarden Dollar einsparen.

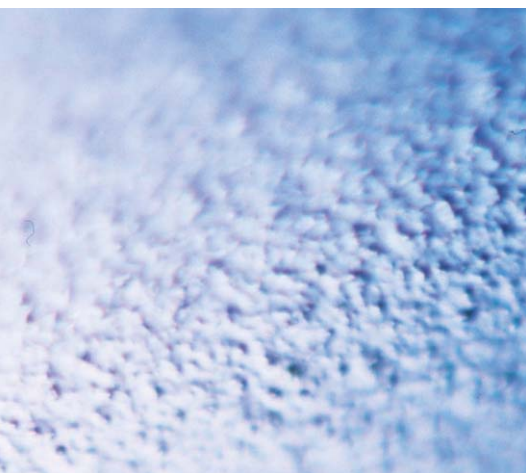


IGBT-Halbleiterschalter
(Insulated Gate Bipolar Transistor)
sind besonders für hohe Ströme
geeignet, wobei sie nur einen
minimalen Steuerstrom benötigen.
Sie werden für leistungsstarke
Antriebe, beispielsweise von
Bahnen, eingesetzt, deren
Energiebedarf sie um die Hälfte
reduzieren können.

ken, indem sie unnötigen Energieverbrauch verhindern. Und zwar überall: Von den Fensterhebern über die Bremsen bis hin zu den Steuerungen für Motor und Getriebe und zur Klimaanlage wird alles ständig auf Einsparungsreserven ausgelotet.

Auch im Haushalt werden die vielfältigen Winzlinge Großes leisten: Schon heute steuern sie in Waschmaschinen der Marken Miele und Bosch-Siemens die Motorendrehzahl; in Zukunft werden sie jedoch vom Aufheizen bis zur Kontrolle der Wassermenge

CoolMOS-Halbleiterschalter können Ströme bei geringstem Widerstand – und damit bei minimaler Abwärme – hervorragend leiten. Sie eignen sich besonders für Geräte mittlerer und niedriger Leistung, etwa für Netzteile für Mobiltelefone, die damit in Zukunft in einen einfachen Stecker passen.



Was die kleinen Bauteile zu all dem befähigt, ist eine komplexe Kette technologischer Durchbrüche. Eine wesentliche Grundlage ist die Dünnscheibentechnik, mit der Infineon weltweit eine Spitzenposition erobert hat: Die Wafer – also die Siliziumgrundplatten, auf die die Halbleiterstrukturen in einem komplizierten Prozess aufgetragen werden – sind nur 70 Mikrometer dünn. Zudem ist es den Infineon Entwicklern gelungen, mit dem CoolMOS-Prinzip hervorragendes Leiten und perfektes Isolieren im gleichen Bauelement zu ver-

einen – Eigenschaften, die sich eigentlich wie Feuer und Wasser widersprechen. Energieflüsse lassen sich damit außerordentlich präzise regeln. Und weil es kaum Widerstand gibt, entsteht nur sehr wenig Abwärme.

Das Ladegerät im Stecker

Damit werden schwere Energiefresser wie Transformatoren oder Gleichrichter überflüssig. Ein Schicksal, das auch die heute üblichen Ladegeräte mit ihrer aufwändigen Kühlung ereilen wird: Die künftigen elektronischen Wandler werden sich kaum mehr erwärmen – Ladegeräte für Mobiltelefone finden so in einem normalen Stecker Platz. Und auch die Stromversorgung für Personalcomputer oder Laptops wird mit den neuen Bauteilen überdacht werden.

Mit den neuen Produkten entsteht eine ganz neue Wettbewerbsdimension: Denn die neuen Chips ermöglichen Geräte, die sich einfacher bedienen lassen und dabei gleichzeitig umweltfreundlicher werden – also Energiesparen ohne Verzicht, ohne den Komfort im Geringsten einzuschränken.

Laut Dr. Reinhard Ploss, Leiter des Geschäftsbereiches Automobil- und Industrielektronik bei Infineon, liegt der Technologievorsprung in diesem Bereich bei rund 15 Monaten. Der Geschäftsbereich hat im Jahr 2001 rund 20 Prozent oder 1,1 Milliarden Euro des Umsatzes erwirtschaftet – Tendenz steigend. Ploss erwartet bei den Leistungshalbleitern, die an den Standorten Regensburg und Villach in Österreich gefertigt werden, „ein überdurchschnittliches Wachstum“.

Vater des Stromspar-Gedankens

Dass Infineon jetzt den Innovationspreis erhalten hat, ehrt die Leistung eines Mannes besonders: die des umtriebigen

Entwicklers Jenoe Tihanyi, dem sich ein gut Teil der Vaterschaft an CoolMOS und IGBT zuordnen lässt. Tihanyi, so Infineon Chef Schumacher, liefere im Durchschnitt mindestens eine Erfindung pro Woche, wovon sich viele auch am Markt durchsetzten. „Seine Innovationen und Erfindungen tragen maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei.“ Im Januar, bei einer feierlichen Gala in der Alten Oper in Frankfurt, überreichte Bundesforschungsministerin Edelgard Bulmahn den Preis: eine Wanderskulptur, in die fortlaufend die Namen der Jahressieger eingraviert werden. Schumacher nahm sie entgegen – stellvertretend für Tihanyi.



Oben: Bei der Übergabe des Innovationspreises (v.l.): Jenoe Tihanyi, Unisys Deutschland-Chief Ulrich Max Müller, Edelgard Bulmahn, Ulrich Schumacher, Reinhard Ploss, Lothar Späth

Unten: Stolz auf die Auszeichnung: Jenoe Tihanyi und Ulrich Schumacher

TITAN INFINEON IM NEUEN DOW JONES BLUE CHIP INDEX

Der US-amerikanische Indexanbieter Dow Jones (DJ) hat einen Blue Chip Index geschaffen, der 30 deutsche Standardtitel umfasst: Seit dem 12. April existiert der so genannte Dow Jones Germany Titans 30, zu dem auch Infineon zählt. Im Wesentlichen setzt sich der neue Index aus den gleichen Werten zusammen, die auch im deutschen Blue Chip Index DAX 30 enthalten sind – abgesehen von MAN und Degussa, die durch Porsche und Altana ersetzt werden. Mit dem neuen Index, der in Konkurrenz zum DAX steht, lassen sich neue Fondsprodukte am Markt platzieren: So genannte Exchange Traded Funds (ETF) bestehen aus den Papieren, die im Index abgebildet sind. Sie gelten als eine gute Alternative zu herkömmlichen Fonds und als Wachstumssegment. Derzeit hält die Hypovereinsbank-Tochter Indexchange ein Monopol auf dem deutschen Markt: Sie handelt den einzigen ETF, der aus den DAX-Werten besteht. Mit dem neuen Index öffnet sich der Markt für die Konkurrenz. Für Frankreich, Italien, die Niederlande, Spanien, Schweden und die Schweiz hat Dow Jones nach dem gleichen Modell ebenfalls neue Standardwerte-Indizes eingeführt. Infineon ist neben diesem und anderen DJ-Indizes auch in den Indexfamilien Deutscher Aktienindex (DAX), Financial Times Stock Exchange (FTSE), Morgan Stanley Capital International (MSCI) sowie Standard & Poors (S&P) vertreten, die das Unternehmen in den verschiedensten regionalen, globalen und branchenspezifischen Indizes listen.

@ Infos: <http://www.infineon.com/boerse/german1/indices.htm>

PROGNOSEN SIGNALISIEREN MARKTERHOLUNG

Es geht wieder bergauf in der Halbleiterbranche: Nach Ansicht des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V. hat eine Markterholung eingesetzt, die sich voraussichtlich weiter fortsetzen wird. Bereits im Februar lag der Halbleiter-Umsatz in Deutschland erheblich über dem des Vormonats, und auch im März hielt das Wachstum bei steigenden Auftragszahlen weiter an. Wenn gleich die Zahlen weit unter denen des Vorjahres liegen, sei eine Verbesserung nun voll im Gange, so der ZVEI. Damit könnte sich die halbjährliche Voraussage der World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) vom Oktober 2001 bestätigen: Die unabhängige Non-Profit-Organisation, die rund 90 Prozent der Halbleiterunternehmen vertritt, hatte ein sich allmählich beschleunigendes, anhaltendes Wachstum für Anfang 2002 prognostiziert.

@ Infos:

<http://www.infineon.com/boerse/links.htm>

INFINEON AUF DER CEBIT

Das war ungewohnt für die weltgrößte Technologiemesse: Die CeBIT konnte in diesem Jahr nicht wie in den Vorjahren mit Besucherrekorden glänzen. Mit rund 700.000 Gästen hat die wichtigste Branchenschau in diesem März rund 18 Prozent weniger Technikfreunde nach Hannover angelockt als im Vorjahr. Dennoch blieb die Zahl der Fachbesucher stabil, und so zeigten sich denn auch die Aussteller – 7.962 Firmen aus 61 Ländern – einigermaßen zufrieden: Sie gaben der Messe die Note Drei plus. Infineon wartete auf der CeBIT mit mehreren Neuheiten auf, darunter mit einer neuen Lösung für den Internet-Zugang per Breitband: Das neue 4-Band-Plan-998-VDSL-Modem garantiert den schnellen Internet-Zugriff und qualitativ hochwertige Media-Dienste; die Serienfertigung soll Ende dieses Jahres beginnen. Zudem präsentierte das Unternehmen das UMTS-Chip-Set „S-GOLD“, das für die Funkübertragung von Hi-Fi-Sound und Video-Bildern sorgt, ohne die Akkulaufzeiten spürbar zu beschränken. Außerdem vorgestellt wurde ein neuer Sicherheitschip für UMTS- und GSM-Mobiltelefone, der Daten so sicher verschlüsseln kann, dass beispielsweise mobiles Banking per Handy möglich wird.

@ Infos: CeBIT 2003 vom 12.–19.3. siehe <http://www.cebit.de>

PATENTSTREIT: RAMBUS UNTERLIEGT INFINEON

Im Prozess um angeblich verletzte Patente der Firma Rambus hat Infineon einen Sieg davongetragen: Ein amerikanisches Gericht wies die Klage in allen 57 Punkten ab und strengte überdies ein Betrugsverfahren gegen Rambus an. 1997 hatte Infineon die Lizenzproduktion so genannter RDRAM-Chips von Rambus gestartet. Die normalen Geschäftsbeziehungen endeten, nachdem Rambus im Juni 2000 für andere Infineon Produkte Lizenzgebühren einforderte und millionenschwere Klagen erhob. Das Infineon Team, das sich sowohl international als auch interdisziplinär aus Juris-

ten, Technologen und Patentexperten zusammensetzt, konnte in der Folge nachweisen, dass Infineon mit seinen SDRAM- und DDR-SDRAM-Speicherchips keinerlei Rambus-Patente verletzt. Das US-Geschworenengericht sprach nun Rambus arglistiger Absichten und betrügerischer Handlungen schuldig. Die Firma, die zuvor auch die Chip-Hersteller Toshiba, Hitachi, NEC, Samsung, Micron und Hynix zum Teil erfolgreich mit ähnlichen Klagen überzogen hatte, muss nun 350.000 US-Dollar Strafe an Infineon zahlen und überdies die Anwaltskosten tragen.

CHIP-STÄRKEN UNTER DER KÜHLERHAUBE

Halbleiter sind aus modernen Autos nicht mehr wegzudenken. In einigen der heutigen High-Tech-Gefährte fahren bis zu 73 Mikro-Controller mit, die Klimaanlage, Sitzeinstellung und Airbag ebenso steuern wie beispielsweise Motor und Getriebe. Infineon belegte im Jahr 2000 mit einem Marktanteil von 13,9 Prozent* den ersten Platz unter den Halbleiterlieferanten für die europäische Automobilindustrie; weltweit liegt das Unternehmen mit 7,3 Prozent* auf Platz zwei. Die neuesten Trends: Umwelt und Sicherheit gewinnen in der Branche zunehmend an Bedeutung; entsprechend konzipieren Infineon Ent-

wickler immer mehr Halbleiter, die den Schadstoffausstoß, das Auslösen von Airbags und die Fahrdynamik optimieren. Wichtig für das Auto der Zukunft sind daneben Kommunikationssysteme – und dabei liegt Infineon mit seiner Kompetenz in der Mobilfunktechnik ganz vorn im Wettbewerb: Schon heute basiert in Europa jedes zweite Auto-Navigationssystem auf Mikro-Controllern des Münchner Chip-Herstellers; in neu entwickelten Systemen korrespondieren zudem Autoradio, Handy, Freisprechanlage und Navigationssystem per Funknetzwerk auf Basis von Bluetooth™ Chips von Infineon miteinander.

*ohne Autoradios

PORTEMONNAIE BALD OHNE KARTENCHAOS

Als „Beste technologische Innovation 2001“ der Chipkarten-Branche wurde der neueste 32-Bit-Chipkarten-Controller von Infineon ausgezeichnet. Für diese Neuentwicklung, die bald mit dem Kartenchaos im Portemonnaie aufräumen könnte, erhielt das Unternehmen Ende 2001 den Sesames Award, der seit sechs Jahren von einer internationalen Jury aus Branchenkennern vergeben wird. Unübertroffen in Rechenleistung und Sicherheitsfunktionen, könnte das Infineon Produkt bald die Daten etwa von Personalausweis, Bankkarte, Kreditkarte, Monatskarte für Bus und Bahn sowie Kaufhaus-Kundenkarte auf einer einzigen Chipkarte vereinen. Der neue Chipkarten-Controller, der garantiert, dass alle Daten und Anwendungen sicher voneinander getrennt bleiben, könnte beispielsweise zukünftige Java™- und Multi-Applikationskarten ausstatten. Um den Sesames Award, der neben der „Besten technologischen Innovation“ auch die „Beste Anwendung“ und „Beste Software“ auszeichnet, hatten sich 86 Einsender aus aller Welt beworben.

ERSTE 1- UND 2-GIGABYTE-SPEICHER AUSGELIEFERT

Infineon hat begonnen, die ersten Entwicklungsmuster von 1-Gigabyte-DDR-SDRAM-DIMMs (Dual Inline Memory Modules) auszuliefern. In Hochleistungs-Personalcomputern, Workstations und in Servern sollen diese Speichermodule die Speicherdichte erhöhen, bei einer höheren Geschwindigkeit für kürzere Ladezeiten sorgen und zudem Qualität und Zuverlässigkeit insgesamt verbessern. Die gleichen Vorteile bieten auch die 2-GB-DDR-SDRAM-DIMMs, von denen demnächst die ersten Funktionsmuster ausgeliefert werden. Sie zielen auf Hauptspeicher-Anwendungen in Workstation- und Server-Umgebungen. Die neuen Module sind die industrieweit ersten Speichermodule, die auf 512-Megabit-ICs basieren, und stellen zugleich die komplexesten Industriestandard-DIMMs dar. Im Vergleich zu den bisher üblichen Modulen können die Systemhersteller damit die Speicherkapazität auf einem Motherboard verdoppeln.

ELEKTRONISCHER FAHRSCHHEIN: EINER FÜR ALLE

Mit der Berliner S-Bahn zum Zug und mit der Dresdner Tram nach Hause – dazu braucht man künftig möglicherweise nur noch ein Ticket. Denn Infineon arbeitet derzeit mit an einem technischen Standard, um bundesweit einen einheitlichen elektronischen Fahrschein einzuführen. Mitte 2003 will das Unternehmen gemeinsam mit dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) eine einheitliche Lösung vorstellen, die dann in Pilotprojekten in Berlin und Dresden getestet wird. Später sollen sich alle rund 530 Verkehrsbetriebe bundesweit an das System anschließen können. Der Chip im Fahrschein kommuniziert dabei kontaktlos per Funk mit

einem speziellen Lesegerät, das der Fahrgast passiert. Eine ausgeklügelte Elektronik schlägt die Brücke zwischen den unterschiedlichen Tarifsystemen, so dass automatisch nur die tatsächlich abgefahrene Strecke in Rechnung gestellt wird und das E-Ticket überall gleichermaßen einsetzbar ist. So richtig bewähren könnte sich der elektronische Fahrschein bei der Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006: Die Fans könnten dann in den unterschiedlichen deutschen Großstädten mit dem gleichen E-Ticket per Bus und Bahn zum Stadion fahren, ohne sich jedes Mal auf ein neues Tarifsysteem einstellen zu müssen.

HÖHERE DURCHSCHNITTSPREISE FÜR SPEICHERCHIPS

Quartalszahlen von Infineon: Nachfragezuwächse in allen Geschäftsbereichen/
Vorsichtiger Optimismus für das nächste Halbjahr

Es geht wieder leicht bergauf am Halbleitermarkt – und das macht sich auch in den Quartalszahlen von Infineon bemerkbar. Auf 1,39 Milliarden Euro ist der Umsatz im zweiten Quartal (bis Ende März 2002) geklettert, das sind 34 Prozent mehr als im vorangegangenen Quartal. Grund dafür ist vor allem, dass Speicherprodukte wieder mehr nachgefragt werden, womit auch die Preise wieder ansteigen. Auch alle anderen Geschäftsbereiche verzeichneten Nachfragezuwächse: Der Absatz stieg bei konventionellen Telekommunikationsanwendungen ebenso wie bei Leistungselektronik für den Automobilsektor sowie bei Sicherheits- und Chipkarten-ICs. Zudem verläuft das im Juli 2001 gestartete Kostensenkungsprogramm Impact sehr erfolgreich, das im laufenden Jahr zu cash-wirksamen Einsparungen in Milliardenhöhe führen soll. Damit lag der EBIT-Verlust mit 178 Millionen Euro um zwei Drittel unter dem des ersten Quartals – trotz des starken Preisdrucks im Automobilbereich und in den Kommunikationssegmenten. Der Verlust pro Aktie lag bei 0,16 Euro, gegenüber einem Minus von 0,48 Euro im vorausgegangenen Quartal. Der Aufwand für Forschung und Entwicklung lag bei 264 Millionen Euro – ein Wert, der in absoluten Zahlen auch gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum stabil geblieben ist, da Infineon kontinuierlich in die Technologien der nächsten Generation investiert.

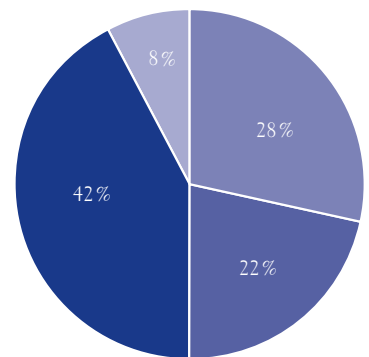
„Wir haben unsere Rentabilität beträchtlich verbessert und gleichzeitig durch Stärkung unserer Technologie- und Kostenführerschaft unsere Wettbewerbsfähigkeit gesteigert. Damit sind wir gut vorbereitet, um weiterhin von einer nachhaltigen Markterholung zu profitieren“, so Infineon Chef Ulrich Schumacher.

Seine Technologie- und Kostenführerschaft konnte Infineon im März mit wichtigen Abmachungen stärken: Mit den taiwanesischen Unternehmen Winbond und Mosel Vitelic kam es zu einem „Memorandum of Understanding“; einerseits wird Infineon ab 2003 seine hoch entwickelte DRAM-Trench-Technologie an Winbond lizenzieren und einen Teil der Produktion übernehmen. Andererseits wurde mit dem bestehenden Partner Mosel Vitelic ein höherer Produktionsanteil vereinbart, so dass Infineon seine DRAM-Kapazität ab dem nächsten Jahr um mehr als 20.000 Wafer-Starts pro Monat erhöhen könnte, ohne große Sachinvestitionen vorzunehmen. Vor allem angesichts der fortgesetzten Konsolidierung am Halbleitermarkt verspricht sich Infineon von diesen strategischen Schritten, seine Marktposition weiter zu festigen.

Um 16 Prozent hat der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation seinen Umsatz gegenüber dem vorherigen Quartal steigern können. Vor allem in Asien hat sich die Nachfrage für traditionelle ISDN- und analoge Telefonanschlüsse leicht erholt. Ebenfalls in Asien konnte Infineon den Markt mit der Breitbandlösung „Ethernet-to-the-home“ weiter durchdringen. Nachgefragt werden außerdem wieder mehr Halbleiter für Glasfaseranwendungen. Hinzu kamen Design-Wins bei wichtigen Kunden, die bei der Entwicklung ihrer Produkte Infineon Lösungen einsetzen.

Auf einen stabilen Umsatz kann der Geschäftsbereich Mobile Kommunikation verweisen, vor allem durch die gleichbleibende Nachfrage für Mobilfunkgeräte: Gegenüber dem Vorquartal stiegen die Verkaufszahlen um ein Prozent auf 208 Millionen Euro. Im zweiten Quartal hat es erneut wichtige Design-Wins gegeben, etwa für die Komplettlösung, die Infineon für den neuen GSM/GPRS-Mobilfunkstandard entwickelt hat. Ein bilaterales Lizenzabkommen wurde zudem mit dem Unternehmen NewLogic Technologies geschlossen, womit Infineon seine Kompetenz für Wireless-LAN ausweiten kann.

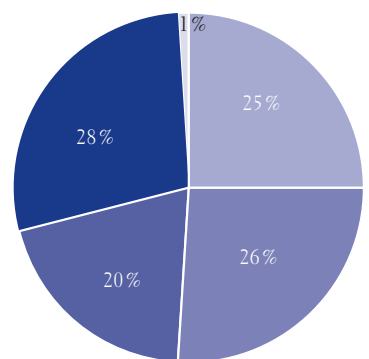
Quartals-Umsatzerlöse in Mio. Euro
Für das Quartal zum 31.03.02



■ Kommunikation: 394 Mio. Euro
 ■ Automobil- und Industrieelektronik: 299 Mio. Euro
 ■ Speicherprodukte: 585 Mio. Euro
 ■ Sonstige und Konzernfunktionen: 107 Mio. Euro

Infineon: 1.385 Mio. Euro

Regionale Umsatzverteilung in %
Für das Quartal zum 31.03.02



■ Deutschland
 ■ Restliches Europa
 ■ Amerika (NAFTA)
 ■ Asien/Pazifik
 ■ Andere

AUSGEWÄHLTE DATEN DER
QUARTALS-KAPITALFLUSSRECHNUNG

FÜR DAS QUARTAL ZUM
31.12.01 31.03.02

	in Mio. Euro	
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-194	-389
Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-115	-120
Abschreibungen	337	347

Infineon Umsatz im zweiten Quartal plus 34 Prozent auf 1,39 Mrd. Euro, steigende Umsatzerlöse in allen Geschäftsbereichen spiegeln moderate Markterholung wider, Nettoverlust verringert auf 108 Mio. Euro durch deutlichen Anstieg der Preise für Speicherchips, konsequente Implementierung des Kostensenkungsprogramms Impact.

Um zehn Prozent auf 90 Millionen Euro stieg der Umsatz im Geschäftsbereich Sicherheits- und Chipkarten-ICs. Zurückzuführen ist das vor allem auf die erhöhte Nachfrage für Sicherheits-Controller. Bedeutende Abschlüsse gab es in den asiatischen Märkten – in Taiwan etwa erhielt Infineon den Zuschlag für das größte Projekt im nationalen Gesundheitswesen, in China für ein Secure-ID-Projekt. Zudem konnte das Unternehmen seine Marktposition für die MultiMediaCard™ stärken, indem es mit der US-Firma Memorex kooperiert, dem

größten Vertreiber solcher Karten. Ein technischer Durchbruch gelang für die Java™-Card, die mit dem 64-Kilobyte-Sicherheitscontroller von Infineon die gesetzlichen Anforderungen für digitale Identifikations (ID)-Systeme übertrifft. Auf 299 Millionen Euro ist der Umsatz im Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik gestiegen, das entspricht einer Steigerung von neun Prozent gegenüber dem Dezember-Quartal. Stark nachgefragt wurde vor allem Leistungselektronik für den Automobilsektor wie Smart Power Switches für Sicherheits- und Komfort-Anwendungen. Steigend sind die Verkaufszahlen zudem im Bereich Motherboards. Für Airbag-Leistungs-ICs gab es einen strategischen Design-Win bei einem führenden US-amerikanischen Automobilzulieferer. Auf großes Interesse bei den Automobilproduzenten stieß der „Telematics Communication Gateway“, der GSM, GPS, Bluetooth™ und Power-Management-Funktionen auf einer Chip-Plattform vereint. Aus dem Unternehmensbereich stammen zudem jene Lösungen, die mit dem Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft gekürt wurden (siehe Seiten 2 und 3).

AUSGEWÄHLTE DATEN DER QUARTALS-
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

FÜR DAS QUARTAL ZUM
31.12.01 31.03.02

	in Mio. Euro	
Umsatzerlöse	1.034	1.385
Umsatzkosten	-1.132	-1.088
Bruttoergebnis vom Umsatz	-98	297
Forschungs- und Entwicklungskosten	-267	-264
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	-164	-165
Betriebsergebnis	-509	-119
Konzernfehlbetrag	-331	-108
Konzernfehlbetrag je Aktie	-0,48	-0,16
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-564	-178

AUSGEWÄHLTE
KONZERN-BILANZDATEN

ZUM
30.09.01 31.03.02

	in Mio. Euro	
Zahlungsmittel	757	1.441
Umlaufvermögen abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten exklusive Zahlungsmittel	-85	128
Bilanzsumme	9.743	10.670
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristig fällige Bestandteile langfristiger Finanzverbindlichkeiten	119	118
Langfristige Finanzverbindlichkeiten ohne kurzfristig fällige Bestandteile	249	1.725
Summe Eigenkapital	6.900	6.488

Mehr als verdoppelt hat sich der Umsatz im Geschäftsbereich Speicherprodukte – er liegt, vor allem durch die Erholung der Speicherpreise, bei 585 Millionen Euro und erhöhte sich damit gegenüber dem ersten Quartal um 105 Prozent. In allen 200- und 300-Millimeter-Fertigungen wurde die 0,14-Mikrometer-Technologie für Standardprodukte erfolgreich qualifiziert. Vorgestellt wurden im März-Quartal Kundenmuster von 256-Megabit-Reduced-Latency-DRAMs und Funktionsmuster von 2-Gigabyte-Modulen. Zudem wurden die Infineon Standard-Speicherchips für alle gängigen Intel-Plattformen zertifiziert.

AUSBLICK: POSITIVE SIGNALE

Ob sich die weltweite Konjunktur weiterhin und vor allem nachhaltig erholt, das beeinflusst auch in den nächsten sechs Monaten wesentlich jene Märkte, auf denen Infineon zu Hause ist. Insgesamt waren die Signale für die Nachfrageentwicklung zum Zeitpunkt der Vorlage der Quartalsergebnisse positiv, wenngleich weiterhin mit starkem Wettbewerb zu rechnen ist, der mit Preisdruck einhergeht. Sollte die erhöhte Nachfrage im Markt für Speicherchips anhalten, könnten sich die DRAM-Preise moderat entwickeln. Zudem erwartet Infineon, dass der Mobilfunkmarkt mit der neuen Generation des GSM/GPRS-Standards weiter wächst. Weiter erhöhte Absatzchancen sieht das Unternehmen auch für Sicherheits- und Chipkarten-ICs, vor allem durch den gesteigerten Bedarf für moderne Sicherheitslösungen. In der Telekommunikations-Infrastruktur rechnet Infineon weiter mit einem schwierigen Marktumfeld, wenngleich die Talsohle ziemlich wahrscheinlich bereits durchschritten wurde. Auf dem Markt für Breitbandzugangs- und DSL-Lösungen ist zudem ein moderates Wachstum abzusehen. Zunehmenden Preisdruck und geringere Wachstumsraten als bisher erwartet Infineon für die Automobilelektronik, hervorgerufen vor allem durch die leichte Abschwächung des weltweiten und besonders des europäischen Automobilmarktes. Dennoch können neue Telematik- und Infotainment-Produkte die Nachfrage steigern, ebenso wie höhere Standards für Komfort- und Sicherheitssysteme.

Hinweis:

Dieses Dokument enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Infineon beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u. a.: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Infineon ist weder geplant noch übernimmt Infineon die Verpflichtung dazu.

NEUES JOINT VENTURE IN TAIWAN

Infineon und die Nanya Technology Corporation aus Taoyuen/Taiwan haben sich auf eine weitreichende und langfristige Kooperation verständigt: Sie wollen am Infineon Standort Dresden gemeinsam die 0,09- und 0,07-Mikrometer-Fertigungstechnologie auf 300-Millimeter-Wafern entwickeln. Zudem planen die Unternehmen ein 50:50-Joint Venture, um eine neue 300-Millimeter-Fabrik in Taiwan aufzubauen. In dem Werk werden dann Standardspeicherchips bereits mit der neuen Technologie gefertigt, die noch kleinere Strukturbreiten für Halbleiter-Chips ermöglicht und damit zu einem Produktivitätsschub führen soll. Ende 2003 wird die Fabrik voraussichtlich in Betrieb gehen; in der ersten Ausbaustufe können im zweiten Halbjahr 2004 monatlich rund 20.000 Wafer verarbeitet werden. Dabei lizenziert Infineon seine hochentwickelte 300-Millimeter-Technologie, mit der auf einer größeren Siliziumgrundplatte zweieinhalb Mal so viele Chips wie bei der bisher üblichen 200-Millimeter-Technologie hergestellt werden können, an Nanya. Das taiwanische Unternehmen sei laut Infineon Chef Schumacher ein idealer Partner für Infineon, da beide auf gleicher technologischer Basis arbeiteten. Schumacher weiter: „Wir verstärken zielstrebig unsere Position in Asien und erhöhen unseren Anteil im weltweiten Markt für Speicherchips.“

INFINEON KALENDER

- 22.07. Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal und die ersten neun Monate (bis 30. Juni) des Geschäftsjahres 2002
- 08.11. Jahrespressekonferenz 2002, Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2002 inkl. des 4. Quartals (bis 30. September)
- 21.01.03 Hauptversammlung/ München

Messen und Ausstellungen

- 14.–16.05. PCIM (Power Electronics, Intelligent Motion and Power Quality) Europe 2002/Nürnberg, Deutschland
- 03.–07.06. Computex/Taipeh, Taiwan
- 04.–06.06. Supercomm/ Atlanta, USA
- 05.–08.06. SmartCards China/ Peking, China
- 11.–14.06. Bluetooth™/Amsterdam, Niederlande
- 03.–05.07. Net World Interop/ Chiba, Japan
- 17.–19.07. Wireless Japan/Tokio, Japan
- 23.–25.07. Automotive Engineering/Yokohama, Japan

IMPRESSUM

INVESTOR NEWSLETTER 02/2002

Herausgeber

Infineon Technologies AG

Investor Relations und
Finanzkommunikation

Postfach 80 09 49

81609 München

Tel.: (0 89) 2 34-2 66 55

Fax: (0 89) 2 34-71 84 84

E-Mail: investor.relations@infineon.com

www.infineon.com/boerse

Redaktion

Katja Bürkle, Verena Raab,

Achim Schneider (verantwortlich)

Gestaltung

OgilvyOne worldwide GmbH & Co. KG,
Frankfurt am Main